

議題研析

一、題目：外國企業在臺設置研發中心之補助法制研析-以美國法之補助追回為借鏡

二、議題所涉法規

產業創新條例、經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法

三、背景說明

據報載，為引領臺灣成為全球高科技研發中心，經濟部啟動「領航企業研發深耕計畫」（下稱「大 A+計畫」），鎖定新興半導體、新世代通訊、人工智慧三大領域，補助申請門檻較高，包括企業必須承諾製造或研發投資達一定規模，研發技術項目須達領先國際水準，期望吸引國際大廠在臺紮根前瞻技術。而超微（AMD）將投資新臺幣 50 億元在臺設立研發中心，並積極爭取經濟部「大 A+計畫」補助。上開計畫之法源依據為產業創新條例第 9 條第 2 項授權訂定之經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法（下稱補助辦法）¹。

四、探討研析

（一）美國晶片法簡介

美國於 2022 年通過 The CHIPS and Science Act of 2022 法案（CHIPS Act，下稱晶片法），對半導體業提供補助及稅捐優惠，以

¹ 王翊綺，〈蘇姿丰演講找華碩、聯想站台「打群架」 砸 50 億在台設 AMD 研發中心〉，2024 年 6 月 3 日，三立新聞網，網址：<https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1478596>，最後瀏覽日期：2024 年 6 月 14 日；經濟部產業技術司，「領航企業研發深耕計畫」，網站：https://aiip.tdp.org.tw/template/aiip_edd/index_2.html，最後瀏覽日期：2024 年 6 月 14 日。

鼓勵半導體業前往美國設廠製造。

在補助部分，為避免美國資金直接或間接使有疑慮之外國政治實體（foreign entity of concern）²受益，故設有柵欄條款（Guardrails Rule/clause），要求受補助人及其關係企業³不得於有疑慮國家進行涉及實質擴產之重大交易，亦不得為涉及美國國家安全之聯合研究或技術授權，否則美國可追回相關補助（Expansion Clawback and Technology Clawback，擴產追回與科研追回），補助款亦不得用於實施庫藏股或發放股利⁴。為使相關補助類型及追回條件更為明確，美國商務部（Department of Commerce）國家標準技術研究院（National Institute of Standards and Technology, NIST）晶片辦公室（CHIPS Program Office, CPO）於2023年9月更公布「防止不當利用晶片法補助」（Preventing the Improper Use of CHIPS Act Funding）之法規命令（Final rule），於2023年11月24日生效⁵，以資補充。

（二）柵欄條款重點

1、科研限制：補助期間內，禁止受補助者使有疑慮之外國政治實體參與涉及引起國家安全問題之技術或產品之聯合研究或技術授權（joint research or technology licensing）⁶

² 15 USC § 4651(8)。

³ 持股比例80%以上，詳見26 U.S. Code § 1504 (a) (2)。

⁴ The White House, 〈FACT SHEET: CHIPS and Science Act Will Lower Costs, Create Jobs, Strengthen Supply Chains, and Counter China〉, 2022年8月9日，網址：<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/>，最後瀏覽日期：2024年6月13日。

⁵ Preventing the Improper Use of CHIPS Act Funding, 美國聯邦公報（Federal Register），2023年9月25日，網址：<https://www.federalregister.gov/documents/2023/09/25/2023-20471/preventing-the-improper-use-of-chips-act-funding>，最後瀏覽日期：2024年6月13日；NIST, Frequently Asked Questions: Preventing the Improper Use of CHIPS Act Funding, 2024年4月24日，網址：<https://www.nist.gov/chips/frequently-asked-questions-preventing-improper-use-chips-act-funding>，最後瀏覽日期：2024年6月13日。

⁶ 15 U.S. Code § 4652 (a) (5) (C)，中文文獻整理自：吳彬詣，〈美國《晶片與科學法》柵欄條款簡析〉，《科技法律透析》，第36卷，第1期，2024年3月，頁37、43-44、47；洪德欽、

聯合研究或技術授權為半導體業廠商製造過程中重要之商業行為，在無國家安全疑慮之考量下，上述法規命令新增例外不受禁止之情形⁷，以降低對廠商正常商業行為之影響，例如：與有疑慮之外國政治實體共同參與國際標準制定組織；對位於有疑慮之外國政治實體境內之關係企業或員工間為聯合研究或技術授權；半導體產業分工細緻，於現有產品之製造、封裝、測試等各流程中，與上下游廠商（其一位於有疑慮之外國政治實體中）間之溝通、設計研發（取得設計圖或其他設計細節等）；由位於有疑慮之外國政治實體境內之合作廠商進行保固、客戶服務等，均不被禁止。

2、擴產限制：補助契約簽訂領取補助後 10 年內，不得在有疑慮之國家（foreign country of concern）進行涉及半導體實質擴產（involving the material expansion of semiconductor manufacturing capacity）之重大交易（significant transaction）⁸

(1) 實質擴產：上述法規命令將之明確定義為提升製造產能逾 5%，產能之認定方式則以增加無塵室、生產線或其他實體空間（cleanroom, production line or other physical space）為標準⁹，使追回補助款與否之認定較為明確。

(2) 重大交易：在法規命令預告階段，曾定義為契約期間內所發生交易總值超過 10 萬美元，但其後刪除，個別認定¹⁰。

(3) 例外得擴產，不受限制之情形¹¹：受補助人於 A. 有疑慮國家之

鄭皓文，〈美國晶片法在 WTO 合法性之研究-兼論晶片法的影響與啟示〉，《月旦法學雜誌》，第 344 期，2024 年 1 月，頁 163。

⁷ 15 C.F.R. 231.105；Preventing the Improper Use of CHIPS Act Funding (A. Comments Related to Subpart A—Definitions：231.123 Technology Licensing)，同註 5。

⁸ 15 U.S. Code § 4652 (a) (6) (C) (i)。

⁹ 15 C.F.R. 231.108；NIST，同註 5。

¹⁰ Preventing the Improper Use of CHIPS Act Funding (A. Comments Related to Subpart A—Definitions：231.121 Significant Transaction)，同註 5。

¹¹ 15 U.S. Code § 4652 (a) (6) (C) (ii)；洪德欽、鄭皓文，同註 6，頁 163。

現存設施 (Existing Facility) 生產傳統半導體 (legacy semiconductor, 或稱成熟製程), 或 B. 即使是新建設施, 所生產傳統半導體主要供應該有疑慮國家。

上開法規命令除有對傳統半導體定義有更細節之規範, 且範圍可能隨時間調整¹²外, 另明定現存設施, 指「訂約前」建造、運行之設施且未進行重大翻修 (產能提升未逾 10%) 者, 而現存設施之產能, 會在補助契約中確認之¹³; 復明定主要供應市場, 指使用半導體製造設施產出 (零件、材料) 所製成之最終產品至少 85% (按價值計算) 以上銷售於該有疑慮國家之市場, 此一高門檻係為避免美國資金之補助產生間接鼓勵低階半導體銷往其他國家之不利效果¹⁴。

3、補助契約 (協議) 應記載事項之明確化

上述法規命令明定補助契約應記載受補助人位於有疑慮國家之現存設施 (包括產能部分, 在簽訂協議時即加以認定並記載之), 或正在與有疑慮外國政治實體進行恐使美國國家安全受到威脅之聯合研究或技術授權¹⁵。

(三) 評析與建議

1、補助法制利弊分析

美國晶片法一方面提供高額補助吸引半導體廠商前往美國設廠, 維護美國高科技產業之領導地位, 一方面為防堵補助款直接或

¹² 15 C.F.R. 231.107; 洪德欽、鄭皓文, 同註 6, 頁 164。

¹³ 15 C.F.R. 231.101; Preventing the Improper Use of CHIPS Act Funding (A. Comments Related to Subpart A—Definitions : 231.103 Existing Facility、231.122 Significant Renovations), 同註 5; 吳彬詣, 同註 6, 頁 40-41。

¹⁴ 15 C.F.R. 231.111; Preventing the Improper Use of CHIPS Act Funding (A. Comments Related to Subpart A—Definitions : 231.114 Predominately Serves the Market), 同註 5。

¹⁵ 15 C.F.R. 231.112 (b); Preventing the Improper Use of CHIPS Act Funding (A. Comments Related to Subpart A—Definitions : 231.115 Required Agreement), 同註 5; 吳彬詣, 同註 6, 頁 41。

間接流入有疑慮國家，影響本國產業優勢及供應鏈安全，故以法律或法規命令課予受補助廠商相對應之負擔或義務，並簽訂補助契約，違反者，可能追回補助款項。因需提供相關資訊（例如於有疑慮國家之工廠設施、聯合研究、技術授權等情形）予美國商務部，以供其審酌是否給予（追回）補助，可能涉及營業秘密，且因於有疑慮國家境內之工廠無法擴產或進行聯合研究，將影響受補助廠商之全球營運布局（減少或停止投資特定國家）¹⁶。是否申請補助，廠商即應衡酌其利弊得失。

而我國有臺版晶片法之稱的產業創新條例，所授權之補助辦法，亦有補助外商規定（參照補助辦法第 6 條），造成臺灣業者憂心扶植外商，並爭搶研發人才，影響臺灣廠商之競爭力¹⁷。

2、補助資格及補助契約、補助款追回等相關規定之細緻化與明確化

查補助辦法第 6 條對外國企業在臺設置研發中心之補助對象有積極資格條件規定、第 15 條有簽訂補助契約及契約約定事項之明文、第 17 條、第 17 條之 1 等為補助款追回規定、第 19 條申請補助之聲明事項及聲明不實之補助款追回規定，對於外國企業運用補助款會否直接或間接挹注與我國敵對勢力地區之產業，損及我國產業競爭力，外國企業應否提供相關資訊（提出聲明或訂入補助契約條款）及違反時之相關效果等，相關內容是否於法制上予以明文化？美國法制或可供審酌。

撰稿人：方華香

¹⁶ 吳彬詣，同註 6，頁 48；吳彬詣，〈產業政策叢生對全球的影響〉，《科技法律透析》，第 35 卷，第 11 期，2023 年 11 月，頁 14。

¹⁷ 江睿智，〈超微砸 50 億在台設研發中心 擬向經部爭取「大 A+計畫」補助〉，《經濟日報》，2024 年 5 月 20 日，網址：<https://money.udn.com/money/story/12926/7974691>，最後瀏覽日期：2024 年 6 月 19 日。